

## Zalecenia dotyczące gruntowania

Stan 06/2008

### KEMPEROL 1K-PUR Izolacja

Nadaje się = ✓

Poniższa tabela stanowi pomoc orientacyjną dla użytkownika i jest jedynie zaleceniem producenta. W odniesieniu do konkretnego podłoża może okazać się konieczne przeprowadzenie próby na przydatność, gdyż zawsze należy mieć na uwadze całościową strukturę uszczelnienia. Wszystkie podłoża muszą być wolne od substancji zmniejszających przyczepność (tłuszcze, środki oddzielające, talk itp. - zobacz też informację tech. TI 21 – ocean podłoża). Niewymienione tu podłoża należy zawsze sprawdzić pod kątem przyczepności!

Podłoża	KEMPERTEC EP / EP5 Podkład	KEMPERTEC D / R Podkład	KEMPERTEC FPO Podkład	KEMPERTEC 1K Podkład
Papa bitumiczna (V 13, V 60, G 200, PYE (SBS))	✓	✓ <sub>4</sub>		✓ <sub>4,8</sub>
Papa bitumiczna APP	Przetestować	Przetestować	Przetestować	Przetestować
Zwierztały asfalt	✓ <sub>4</sub>	✓ <sub>4</sub>		
Membrany z tworzyw sztucznych (EPDM, ECB, PVC, PE, PP, PIB, EVA)	Przetestować	Przetestować	Przetestować	Przetestować
Membrany z tworzyw sztucznych FPO lub TPO			✓	
Płyty budowlane (np. beton włóknisty)	✓	✓ <sub>4</sub>		✓ <sub>4,8</sub>
Klinkier, cegły, mury zewnętrzne (przeszlifować)	✓	✓ <sub>4</sub>		✓ <sub>4,8</sub>
Beton / jastrych	✓			✓ <sub>4,8</sub>
Jastrych i zaprawy modyfikowane tworzywami sztucznymi (PCC)	✓			Przetestować
Błoczeki budowlane (z lekkiego beton, wapienno- piaskowe, betonowe, gazobetonowe, pumeksowe itp.)	✓	Przetestować		Przetestować
Szkoło (nieuszlachetnione) oczyszczone zmywaczem MEK	✓	Przetestować		
Cynk, stal ocynkowana	✓ <sub>2,3,4</sub>	✓ <sub>2</sub>		✓ <sub>2,3,4</sub>
Miedź, ołów	✓ <sub>2</sub>	✓ <sub>2</sub>		✓ <sub>2,3,4</sub>
Stal, stal nierdzewna (V2A, V4A), Aluminium	✓ <sub>2,3</sub>	✓ <sub>2,3,4</sub>		✓ <sub>2,3,4</sub>
Izolacja termiczna z otwartymi porami (polystyrol, wełna mineralna, wełna szklana)	✓ <sub>4,6</sub>	✓ <sub>4,6</sub>		✓ <sub>4,6</sub>
Izolacja termiczna z zamkniętymi porami (poliuretan itp.)	✓ <sub>4,6</sub>	✓ <sub>4,6</sub>		✓ <sub>4,6</sub>
Płyty drewniane-, wiórowe-, OSB, sklejka	✓ <sub>4,6</sub>	✓ <sub>4,6</sub>		

2 Konieczność oczyszczenia uszczelnianych elementów mechanicznie jak i zmywaczem KEMPERTEC® MEK.

3 Przy podwyższonych wymaganiach zaleca się mechaniczne zamocowanie

4 Na tych podłożach wymagana jest szerokość uszczelnienia większa niż 15 cm .

6 Zalecana warstwa rozdzielająca, zgodnie ze wskazówkami dla płaskich dachów – w kombinacji z zawierającymi rozpuszczalniki produktami KEMPEROL®

8 Mieć na uwadze informację tech. dot. podkładu KEMPERTEC® 1K i informację tech. TI 23 – wyroby oparte na rozpuszczalnikach

Korzystając z powyższej tabeli muszą być dokładnie spełnione zalecenia obróbki i techniczne wskazówki podane przez firmę KEMPER SYSTEM. Prosimy mieć na uwadze naszą klauzulę reżymu dot. doradztwa technicznego

## **Czas na obróbkę – czas cieczy:**

Pod pojęciem - czas cieczy przy materiałach reagujących mówimy o czasie, który mamy do dyspozycji od momentu wymieszania komponentów (produkty wielokomponentowe) lub otwarcia pojemnika (produkty jednokomponentowe) do momentu jego wiązania (gęstnienia). Inaczej mówiąc, rozpiętość czasu kiedy produkt znajduje się jeszcze w stanie ciekłym i daje się wylać z pojemnika. Przy naszych produktach czas na obróbkę i czas cieczy z reguły nie jest jednakowy!

Uzasadnione jest to tym, że czas cieczy można ustalić przy pomocy lepkościomierza, jest on jednak dłuższy od czasu, w którym produkt można użyć do obróbki.

Zmiana gęstości cieczy, ma oczywiście wpływ na wsiąkanie i przesączenie jeśli chodzi o podłoże i włókninę.

Przy końcu czasu cieczy lepkość produktu jest tak wysoka, że użycie zgodne z przeznaczeniem jak również przyczepność do podłoża jest niemożliwe. Z tego powodu czas na obróbkę leży około 3 – 5 minut poniżej mierzonego przez nas czasu cieczy.

Jako regułę stosowaną w praktyce można przyjąć, że produkty które zdecydowanie przekroczyły lepkość płynnego miodu (~ 10000 mPas) nie powinny być dalej użyte

## **Nakładanie dalszych warstw:**

W tym przypadku mówimy o rozpiętości czasu do najwcześniejszego możliwego nakładania dalszych warstw. Ta rozpiętość czasu będzie z jednej strony podyktowana osiągnięciem odpowiedniej twardości lub stopnia związania materiału, a z drugiej strony czasem potrzebnym na odparowanie rozpuszczalników.

W zależności od pogody następne warstwy powinny być rozłożone w przeciągu 14 dni

## **Posypka piaskowa:**

Przy użyciu dwuskładnikowego podkładu zaleca się generalnie stosowanie posypki piaskowej .

Niezbędne jest stosowanie posypki piaskowej przy użyciu produktów na bazie żywicy epoksydowej (podkład KEMPERTEC® EP i KEMPERTEC® EP5). Poprzez posypanie podkładu piaskiem kwarcowym (500-1000gr/m<sup>2</sup>)

osiągnie się odpowiednią porowatość powierzchni. Porowatość ta pomaga w tworzeniu optymalnej przyczepności następnym warstw. Drugim zadaniem posypki piaskowej jest ochrona podkładu przed promieniami UV, szczególnie kiedy przerwa w pracach izolacyjnych jest dłuższa niż 14 dni.

## **Produkty:**

Podkłady KEMPERTEC® - są odporne na procesy starzenia – nie są odporne na promieniowanie UV.

Produkty izolacyjne KEMPEROL® - posiadają odporność na procesy starzenia jak również na promieniowanie UV.

Dekoracyjne produkty KEMPERDUR® - posiadają odporność na promieniowanie UV i odbarwienie.

## **Odporność na UV:**

Odporność naszych produktów izolacyjnych na procesy starzenia się pod wpływem promieni UV jest udowodniona zgodnie z europejskimi wytycznymi ETAG 005.

## **Odporność na światło:**

Stabilność i odporność kolorów na światło(UV) i wpływy środowiska.

## **Żółknienie:**

Ponieważ do naszych produktów izolacyjnych nie stosujemy światłoodpornych surowców, może być widoczne żółknienie w zależności od pogody i działania promieni UV, które jednakże nie obniża skuteczności izolacji.